

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-011

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如下：

一、向金融机构申请综合授信情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信期限为 1 年至 5 年（以银行批准的实际授信期限为准）。上述公司贷款可以公司及子公司（含孙公司）的自有资产进行抵押、质押担保。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定（最终以金融机构与公司实际发生的融资金额为准）。

上述综合授信额度需提交 2024 年第二次临时股东大会审议批准，股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的

授权代理人代表公司及子公司（含孙公司）办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。2024 年第二次临时股东大会通过后，公司原 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接。

二、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

董事会认为：公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保事项。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日